

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 线上路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	东方财富证券研究所（崔晓静、王磊、陈怡洁、王启帆、姜倩慧、朱晋潇、陈思颖、张明远、王佩麟、陈磊）；国联民生（武慧东、朱思敏）；东北证券（庄嘉骏）；中国国际金融股份有限公司（胡迪、李梦遥）；中信建投基金管理有限公司（李源、刘泊宁、丁希璞）；深圳榕树投资（黄安麟）；华夏基金管理有限公司（张越洋）；佳许盈海（上海）私募基金管理有限公司（靳存迎）；易方达基金管理有限公司（李凌霄）；博时基金管理有限公司（冯圣阳、乔奇兵、田俊维、高晖、何坤）；南方基金管理股份有限公司（薛原）；工银瑞信基金管理有限公司（文杰）；Willing Capital（Hongda Zhu）；IGWT Investment（廖克铭）；汇添富基金管理股份有限公司（郑磊、马翔）；永赢基金管理有限公司（张海啸）；上海杭贵投资管理有限公司（饶欣莹）；国富人寿（程勇）；建信理财有限责任公司（胡韬）；人保资产（吴若宗）；嘉实基金管理有限公司（徐鹤洋）；北京同巨投资有限公司（孙苗苗）；上海汐泰投资管理有限公司（杨鸿达）；金信基金管理有限公司（曾艳）；深圳大风资产管理有限公司（丁威）；太平洋资产管理有限责任公司（袁元、王紫艳）；东吴基金管理有限公司（张浩佳）；鹏扬基金管理有限公司（王杨）；中银理财有限责任公司（郭艳超）；上海高澈投资管理有限公司（蒋明甫）；上海石锋资产管理有限公司（王文杰）；泉果基金管理有限公司（张希坤）；友邦人寿保险有限公司（许敏敏）；上海盘京投资管理中

心（有限合伙）（马欣）；溪牛投资管理(北京)有限公司（陈舜奇）；北京橡果资产管理有限公司（魏鑫）；江苏瑞华投资控股集团（章礼英）；建信养老金管理有限责任公司（刘洋）；红杉中国（闫慧辰）；财通基金管理有限公司（徐婧华、林承瑜）；深圳创富兆业金融管理有限公司（李默凡）；上海度势投资有限公司（顾宝成）；肇万投资（崔磊）；银华基金管理股份有限公司（邵子豪）；国金证券（王龙）；汐泰投资（杨鸿达）；华安基金（胡哲）；大成基金（刘照琛）；兴证全球基金管理有限公司（邹欣）；人保资产管理有限公司（李哲超）；西部证券（李华丰）；财通基金管理有限公司（徐婧华）；红土创新基金（刘君杰）；友邦人寿保险有限公司（许敏敏）；浙江龙航资产管理有限公司（颜孝坤）；浙江龙航资产管理有限公司（颜孝坤）；咸和资产（刘建刚）；北京京管泰富基金管理有限责任公司（陈谦）；深圳市凯丰投资管理有限公司（王东升）；华富基金管理有限公司（薛辉蓉）；浙江农资集团投资发展有限公司（张旖芬）；中银基金管理有限公司（华旭桥）；中邮创业基金管理股份有限公司（王欢）；招商基金管理有限公司（吴德瑄）；珠海德若私募基金管理有限公司（罗采奕）；合众资产管理股份有限公司（张看）；华福证券（刘武）；第一创业证券股份有限公司（俞秀英）；上海南土资产管理有限公司（王可）；长信基金管理有限责任公司（程昕）；青岛中航赛维投资有限公司（吕政和）；上海复朴资产管理有限公司（范恩辉）、禧悦投资（王秀平）、申万菱信（刘毅男）、华安证券（杨光）；上海朴道瑞富投资管理中心（王厚友）；陆家嘴国际信托有限公司（叶柯辰）；展博投资（肖斌）；融通基金管理有限公司（张鹏）；深圳亘泰投资管理有限公司（吕科）；财通证券（谢丹妮）；方正证券（黄雪茹）；中信证券（冷威）；国金证券（陈伟豪）；山丘资产管理（北京）有限公司（尹星龙）；光大保德信（李心宇）；明富基金（欧阳凡）；敦和资管（李乾）；中宏人寿（汪孝亮）；人保公募（王辉）；银河证券（贾亚萌）；北恒基金（李英文）；观富投资（张昊）；华泰证券（方晏荷、王玺杰）；太平养老保险股份有限公司（张浩、张凯）；证券时报（刘莎莎、康殷）；华夏久盈资产管理有限责任公司（桑永亮）；高毅投资（朱春禹）；百年保险资产管理有

	限责任公司（蒋捷）；华创电新（蒋雨凯）；财通证券（陈琳云）；方正证券（韩宇）；财通证券（朱陈星）；山西证券（高宇洋）；澄金资产（崔宇婷）；熵盈基金（刘翔）。
时间	2025年6月3日（周二）下午16:00~17:00
地点	线上电话会
上市公司接待人员姓名	1、广东星空科技装备有限公司董事长：贺荣明先生 2、中旗新材董事长兼总经理：周军先生 3、董事会秘书：张祺文女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况，如下：</p> <p>1、本次星空科技与中旗新材的合作受到广泛关注，能否请简要介绍一下本次合作的背景？</p> <p>本次合作，核心可以归纳为两点：第一点，中旗新材是一家在建材领域深耕多年的企业，属于偏传统行业。但近几年已经开始谋求转型，重点是从材料端出发，探索如何为半导体及泛半导体领域提供服务，寻找新的增长点。星空科技则是一家专注于高端装备制造与集成服务的高科技企业，我们对半导体行业非常熟悉，在自身业务以及客户层面，对新材料也有清晰的认知和明确的需求。因此，在这一层面，双方的合作能够帮助中旗新材在材料高端化方向实现突破，逐步具备服务半导体行业的能力。</p> <p>第二点，这次合作还承载着中旗新材主业扩容和产业升级的重要意义。也就是说，我们将星空科技在高端装备领域的技术能力和产品体系，逐步与上市公司平台进行深度融合，使中旗新材不仅能在材料领域迈向高端制造，更具备向高端装备行业拓展的潜力。</p> <p>这就是我们此次合作在转型方面的两大核心意义。</p> <p>虽然星空科技成立时间不长，但我们团队在半导体装备研发方面拥有超过20年的经验。我们的主要产品聚焦于国家当前最重要的发展方向——即围绕人工智能应用专用芯片制造所需的关键装备。</p> <p>这些设备主要包括大视场专用光刻机、芯片键合机、硅片芯</p>

片键合机、光学检测设备等。

2、近几年，国家对人工智能产业高度重视，尤其是在芯片领域投入了大量关注。请贺总先为我们简要介绍一下公司产品未来的发展前景。

答：公司的产品主要定位于未来的先进封装技术，包括 2.5 D、3D 封装，以及面向人工智能应用的芯片制造所需的特殊设备的设计、开发与制造。目前，星空科技已初步形成了光刻机系列、纳米压印系列、芯片键合系列、硅片键合系列以及光学检测系列等多个产品体系。

目前，大部分产品已实现市场投放，部分新产品也在持续研发中。我们对 AR 市场和人工智能应用市场的前景非常看好，随着 AI 应用的持续扩展，AI 芯片对算力的需求不断提升，相应也带动了芯片制造装备在应用端的持续增长。

因此，星空科技始终围绕这些高端装备领域，秉持提升自主创新能力的目标，持续开发契合我国行业需求的关键设备，逐步实现技术自主化，为行业提供安全、可靠的本土化服务。这也是星空科技产品的核心定位所在。

3、请问未来中旗新材整个产业的整合，包括未来资产并购的节奏如何？

答：成为中旗新材的股东以后，我们将有序推进几方面工作。第一步，我们会继续支持和推进上市公司在传统材料生产制造基础上，开发半导体领域材料的新需求，不断提升传统材料的技术档次。

第二步，我们会推动星空科技的高端装备与上市公司紧密结合，上市公司除了现有材料业务之外，将转型为一个以高科技装备为背景、材料相辅的产品结构。当然，这个过程需要一定时间，时间的长短会考虑几个因素。第一个是产品导入和切换的效率，要确保业务稳定，保持公司的稳态发展，这是我们的首要原则。第二个原则是尽量减少转换的管理成本，我们会选择合适的路

径,最大程度地将精力放在公司业务发展上,有效控制管理成本。第三个是考虑两家公司合作的融合,争取产生加法效应甚至乘法效应。基于这些因素,我们会制定合理的推进步骤。相关步骤发生时,会根据上市公司有关规定,及时披露相关信息。

随着时间推移,大家会逐步看到目标清晰,过程会根据环境和时机做出相应调整。

4、星空科技目前主营业务是什么,未来重点的研发方向如何?

答:星空科技目前的主营业务主要是高端装备。从产品系列来看,我们有几个系列。第一个系列是特殊用途专用光刻机系列;第二个系列是芯片键合系列;第三个系列是硅片键合系列;第四个系列是光学检测设备系列;第五个系列是纳米压印系列。这些是我们目前已有的产品,产品的性能、技术指标会根据客户需求及时进行迭代和升级。我们的代表产品已经投放市场。从应用角度来看,这些产品主要围绕3D封装、先进封装以及人工智能芯片制造的关键需求。

未来,星空科技将持续保持高强度的研发投入,持续开发高端装备,不断满足客户对工艺不断提升的需求。在我国人工智能从应用端到制造端的产业链中,扮演重要角色,贡献我们的力量。

5、星空科技的光刻机是否具备I线产品?除了特殊的后端高端封装外,在线产品是否也可以应用于我们常见的成熟制程,或者功率半导体的使用场景中?

答:是的,我们目前用于封装的光刻机本身就是I线产品,实际上我们拥有三线,即i线、g线及h线三种不同的产品规格。未来,我们会根据工艺需求,持续更高性能的光刻设备,以满足客户的不同需求。

6、请问,现在I线的产品,如果说和日本的佳能、尼康来做对比的话,大概相当于他们的哪个型号的产品?

答：目前星空主要聚焦于先进封装领域，先进封装的对标产品主要不是佳能和尼康。但在先进封装领域，我们已经能够实现微米级精度，并且预计在今年下半年，产品将达到亚微米水平，大约在 0.7 到 0.8 微米左右，这在先进封装领域属于较高端的指标。

7、请问星空科技在先进封装光刻机的研发和客户应用方面，目前进展到什么阶段了？

答：光刻机我们已经交付给客户，具体进展因客户而异。有些设备正在客户现场试用，有些进入了工艺实验等不同阶段。总体来说，我们从去年开始投放市场，正在逐步加深这方面的应用。目前已经拓展了客户群，有的客户正在进行工艺开发与设备匹配，有的已经开始投入生产。每台设备的进展情况有所不同。

8、星空科技产品和国内同行竞争对手的产品，在性能或者这个参数上有哪些优势？

答：国内在高端装备领域，虽然各家公司产品名称和类型相似，但性能指标各有不同。现在我不能明确说我们处于何种优势位置，但从我们的战略布局和追求来看，目标是做到国内领先、国际先进。我们始终坚持打造高性能的专用设备，只有这样才能满足客户需求，赢得竞争优势。这是我们长期且不懈的追求。

国内也有一定数量的竞争对手，大家相互切磋、共同竞争。我相信，这对我们的客户是有益的。因为只有通过合理的竞争，企业才能持续保持高研发投入，不断开发新产品。我认为，这对客户和整个行业的发展都是有利的。

9、请贺总介绍一下整体的人员配置和未来大致的展望？

答：目前星空科技团队主要由研发和工程人员组成，研发人员约占公司总人数的 60%。随着批量生产和重复生产的逐步增加，这一比例可能略有调整。也就是说，星空科技大致会保持有一半左右的员工专注于研发、新产品开发和工程化能力的提升。这是我们目前的人才结构情况。谢谢！

	<p>10、星空科技与国内现有几家光刻机企业相比，有哪些差异？国内同行目前的市场定位如何？</p> <p>答：我们的光刻机主要面向人工智能芯片制造这一庞大的市场，由于工艺的独特性，我们的光刻机在技术路线和应用对象上，与现有已问世的光刻机有较大差异。这也是星空科技在光刻技术领域的独特布局。</p> <p>11、星空科技目前量产机型的供应链国产化率大概处于什么水平？是否能够完全依赖国内供应商，无需从海外采购？</p> <p>答：我们的国产化竞争力较强，但这并不意味着完全排除国际供应商。对于一些关键配套环节，我们会主动规避潜在风险。总体来看，我们的产业链目前保持在一个相对安全且可控的状态。</p> <p>12、请问借由这个股转形式实现了证券化，您对公司未来的期许是什么呢？</p> <p>答：我认为证券化只是手段，而非目的，目的在于促进企业更好地发展。坚持自主研发和持续发展是我们的重要方向，但同时也不排斥通过合作和并购来丰富和扩大产品线，包括提升供应链的多样性。具体何时及如何实施，我们还在规划中。但有了资本平台的支持，战略的实施将更为顺利。因此，整体来看，这是一条非常积极且有前景的发展方向。我们会积极利用资本市场的各种工具，推动公司实现更高质量、更健康、更稳健的发展。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025-06-03